

# PCB 专业术语注解

订 单 类	Part No.		料号	General information	普通信息
	Questions		问题	Contact	联系
	Technical		技术性	TEL	电话
	Order information		订单信息	Revision level	修订版本
	Vendor		供应商	Type of order	订单类型
	Quantity		数量	Price each	单价
	Vendor status		供应商状态	File name	文件名
	Multilayer		多层板		
出 货 要 求 类	Delivery information		交货资料	Attach with delivery	出货附加
	E-test report		测式报告	Microsection report	切片报告
	Final inspection report		出货检验报告	Impedance test report	阻抗测试报告
	Cross-section		切片	Solder sample	焊锡样板
	Inoic testing	离子污染度测式	Tape test	撕胶带试验	
	Optical Inspection		光学检验	Visual Inspection	目视检验
	Hipot test		高压电测	Yield	良品率
板 材 要 求 类	Material(FR-4,CEM-1,CEM-3,FR-1)		板材	Copper foil	铜箔、铜皮
	Copper clad epoxy glass laminate		玻离树脂覆铜板	Tg rating	Tg 点级别
	Tg:(glass transition temperature)		玻离化温度	Td:(Temperature decomposition)	固化温度点
	Polt tetra fluoro ethylene(PTFE)		铁氟龙	Core	芯板(芯料)
	Combination		粘结物(PP)	Laminate type	板材类型
	Layer count		层数	Base copper foil	基材铜厚
	Lay up setup		压合结构	Dielectrics specified	介质规格
	Lay up		叠合	Gel time	凝胶时间
	Halogen free materials		无卤素板材	Dielectric layer	介质层
	Insulator		绝缘层	Toflon	铁氟龙
	Length wise dimension		径向	Cross wise dimension	纬向
	Prepreg Prepreg (PP)		树脂胶片	Laminate	基板、保层板
	94HB (非防火级别料)		纸基材料	FR-4 (防型号)	玻纤材料
Pressing		压板	Board cut	开料	
钻 孔 电 镀 类	Plating	电镀	Plated through hole copper thickness		孔壁铜厚
	Sencondary drill		二次钻孔	Drill chart	分孔图、表
	Hole count		孔数	Smallest hole size	最小孔径
	Drill file		钻孔文件	Hole	孔
	Drilling		钻孔	Counter boad	沉头孔
	Counter sink		锥形孔	Component hole	零件孔
	Via hole		导电孔	Slot/Slotting	槽孔
	Hole locations		孔位置	Fabrication drawing	制造图
	PTH		镀通孔, 沉铜		

## PCB 专业术语注解

内 外 层 线 路 类	Minimum line width		最小线宽	Minimum spacing		最小间距
	Outer layer		外层	Inner layer		内层
	Top-only		顶层	Bottom-only		底层
	Netlist testing required		要网络测试	Impedance control		阻抗控制
	OHM		电阻单位Ω	Top circuit		顶层线路
	Conductor width		导线宽度	Differential resistart		差动(阻抗)
	Signal		信号	Plane		大地
	Min trace		最小线宽	Surface		表面
	Singel end		单端	Etch		蚀刻
	Copper border		板边设计	Tent		盖油
	Fiducial uark		光学点	Surround by land		环绕接地
	Signal line		信号线	Referance plane		参考层
	Ground plane		接地层	Tab		接点、金手指
	Non-Circular land		非圆形PAD	Lead pitch		脚距
	Lag out		布线、布局	Fine line		细线
	Transmission line		传输线	Pitch		跨距、步距
	Fine pitch		密距	Film		底片(菲林)
	Layer		层			
阻 焊 文 字 类	Solder mask	阻焊	Plugged(filled) soldermask in via hole		导电孔塞油	
	Legend		文字	Via hole treatment		导电孔处理
	Double side		双面	Color		颜色
	Green		绿色	Red		红色
	Blue		蓝色	Black		黑色
	White		白色	Matte		哑色
	Gloss		半光亮	Light		亮色
	Solder mask color		防焊颜色	Solder mask type		防焊类型
	Solder mask sides		防焊层	Plug via holes		导通孔塞孔
	On comp side		在零件面	On sold side		在焊接面
	Dry film gloss		干膜绿油	Silk screen		丝印(文字)
	Vendor logo and ul		UL 和图标	Photimageable		液态感光油
	Solder resist		焊锡保护层	W(Week)		周
	Y(Year)		年	Month		月
	Date code		周期	Date		日期
	WKYR(WWYY)		周周年年	WKYR(YWYW)		年年周周

## PCB 专业术语注解

表面处理类	Surface finish	表面处理	HAL(hot air leveling)	喷锡
	Immersion gold	沉金/化金	Flash gold	镀金/水金
	OSP	抗氧化	Hasl & gold finger	喷锡+金手指
	Smobc with hasl	喷锡板	Carbon	碳油
	Top paste	顶层锡膏	Solder paste	锡膏
	Hot air solder levelled	喷锡	Lead free	无铅喷锡
	Immersion tin	沉锡/化锡	Immersion silver	沉银/化银
	Peelable mask (可剥胶)	蓝胶	Silver paste	银膏
	Nickel gold immersion	化镍金		
外形外观类	Overall board thickness	总板厚	Finish thickness	成品板厚
	Bevel angle	斜边角度	Gold finger bevel	金手指斜边
	Bevel depth	斜边深度	Board or unit size	板子单元尺寸
	Array size	排版尺寸	Scoring angle	切割角度
	Finished Web Thickness	残厚	Finish Type	成品类型
	Outline	外形	Break Away	拆断边
	Tolerance	公差	Board Size	板的尺寸
	Dimensional Tolerance	尺寸公差	Rectangle	矩形
	Fabricable PCB	PCB 成形	Probe	探针
	Flatness	平坦度	Short	短路
	Insulation	绝缘电阻	Punch	冲切(模冲)
	Omega meter	污染检测	Contact resistance	接触电阻
其它相关英文	Measure	测量	Format	(周期) 格式
	As Original Geber File	按原档	None	无
	Mark	标记	Date Code	日期
	Detail	详解	Test Stamp	测式印章(ET
	See Spec Note	看规范要求	Acceptance Specification	接收标准
	Reference	提及、关于	Connection	联结
	Data	数据	Where	哪里?
	May	可以	Use	使用
	With In	在.....以内	Or	或者
	Modify	修改	Meet	达到
	Requirements	要求	Notify	注意事项
	Prior	预先、提前	Not more than	不超过
	Monday	星期一	Tuesday	星期二
	Wednesday	星期三	Thursday	星期四
	Friday	星期五	Saturday	星期六
Sunday	星期日	BOW (板弯) TWIST 板翘		

## PCB 制作基本英文词汇

### 流程

Board cut	开料	Carbon printing	碳油印刷
Inner dry film	内层干膜	Peelable blue mask	蓝胶
Inner etching	内层蚀刻	Pressing	压板
ENIG(Electroless nickel immersion gold)	沉镍金	Punching	啤板
Inner dry film stripping	内层干膜退膜	HAL(hot air leveling)	喷锡
AOI (Automatic Optical Inspection)	自动光学检测	Drilling	钻孔
OSP (Organic solderability preservative)	有机保焊	Profiling	外形加工
Desmear	除胶渣, 去钻污	E-Test	电性测试
PTH	镀通孔, 沉铜	FQC(final quality control)	最终品质控制
Panel plating	整板电镀	FQA(Final quality audit)	最终品质保证
Outer dry film	外层干膜	Packing	包装
Etching	蚀刻	IPQA(In-process quality audit)	流程 QA
Tin stripping	退锡	IPQC(In-process quality control)	流程 QC
EQC (QC after etching)	蚀检 QC	IQC(Incoming quality control)	来料检查
Solder mask	感阻	MRB(material review board)	材料评审委员会
Component mark	字符	QA(Quality assurance)	品质保证
Physical Laboratory	物理实验室	QC(Quality control)	品质控制
Chemistry Laboratory	化学实验室	Document control center	文件控制中心
2 <sup>nd</sup> Drilling	二钻	Routing	锣板, 铣板
Brown oxidation	棕化	Waste water treatment	污水处理
V-cut	V 坑	WIP (work in process)	制作过程
Store/stock	仓库	F.G(Finished goods)	成品

### 概述

Printed Circuit Board	印制电路板	Flexible Printed Circuit, FPC	软板
Double-Side Printed Board	双面板	Base Material	基材
IPC (The Institute for Interconnecting and Packing Electronic Circuits)	电子电路互连与封装协会		
CPAR (Corrective & Preventive Action Request)	要求纠正预防措施		
Flammability Rate	燃性等级	Characteristic impedance	特性阻抗
BUM (Build-up multilayer)	积层多层板	Date Code	周期代码
CCL (Copper-clad laminate)	覆铜板	Ionic contamination	离子性污染
Acceptance Quality Level (AQL)	允收水平	Radius	半径
HDI (High density interconnecting)	高密度互连板	Diameter	直径
Capacity	生产能力	PPM(Parts Per Million)	百万分之几
Capability	工艺能力		
CAM (computer-aided manufacturing)	计算机辅助制造		
Underwriters Laboratories Inc.	美国保险商实验所		
CAD (computer-aided design)	计算机辅助设计	Via	导通孔
Statistical Process Control	统计过程控制	Specification	规格, 规范
Dimension	尺寸	Buried /blind via	埋/盲孔
Tolerance	公差	Tooling hole	定位孔
Oven	焗炉	Output/throughput	产量

### 湿流程

PTH (plated through hole)	镀通孔 (俗称沉铜)	Acid cleaning	酸性除油
PP(Panel Plating)	板电	Acid dip	酸洗
Pattern plating	图电	Pre-dip	预浸

Line width	线宽	Alkaline cleaning	碱性除油
Spacing	线隙	Flux	松香
Deburring	去毛刺 (沉铜前磨板)	Hot air leveling	喷锡
Carbon treatment	碳处理	Skip plating	跳镀, 漏镀
Track/conductor	导线	Undercut	侧蚀
Aspect ratio	深径比	Water rinsing	水洗
Etch Factor	蚀刻因子	Transportation	行车
Back Light Test	背光测试	Rack	挂架
Pink ring	粉红圈	Maintenance	保养

## 干流程

Hole location	孔位	Annular ring	孔环
Image Transfer	图象转移	Component Side(C/S)	元件面
Artwork	底片	Solder Side(S/S)	焊接面
Mylar	胶片	Matte Solder Mask	哑绿油
Silkscreen/legend/Component Mark	文字	Hole breakout	破孔
Fiducial mark	基点, 对光点	Scrubbing	磨板
Expose	曝光	Developing	显影

## 内层制作

Core material	内层芯板	Thermal pad	散热 PAD
Pre-preg	PP 片	Resin content	树脂含量
Kraft Paper	牛皮纸	Brown oxidation	棕化
Lay up	排版	Black Oxidation	黑化
Registration	对位	Base material	板材
Delamination	分层		
<b>其它</b>			
Wicking	灯芯效应	Hole size	孔径(尺寸)
Yield	良品率	Touch Up	修理
Warp and Twist	板曲度	Solvent Test	溶剂测试
Peel off	剥离	Company Logo	公司标识
Tape Test	胶纸试验	UL Mark	UL 标记
Cosmetic	外观	Function	功能
Tin/Lead Ratio	锡/铅比例	Reliability Tests	可靠性试验
Hole Wall Roughness	孔壁粗糙度	Base Copper Thickness	底铜厚度

## PCB 专业英语(PCB SPECIAL ENGLISH)

Pad	焊盘	Annular ring	焊环
AOI=automatic optical inspection	自动光学检测	Charge of free	免费
WIP=work in process	工作进度	DCC=document control center	文控中心
CS=Component Side =Top Side	(顶层) 元件面	SS=Solder Side =Bottom Side	(底层) 焊锡面
Gold Plated	电金, 镀金	Nickel Plated	电镍, 镀镍
Immersion Gold	沉金=沉镍金	Carbon Ink Print	印碳油
Microsection Report	切片报告, 横切面报告	X-out=Cross-out	打"X"报告
Panel (客户称) 拼板, (生产线称) 工作板		Marking	标记, UL 标记

Date code 生产周期	Unit 单元, 单位
Profile 外形, 轮廓<outline>	Profile By Routing 锣(铣)外形
Wet Film 湿菲林,湿绿油,湿膜	Slot 槽,方坑
Base Material=Base Laminate 基材,板料	V-out =V-score V 形槽
Finished 成品	Marketing 市场部
Gerber File GERBER 文件	UL LOGO UL 标记
E-Test=Electric Open/Short Test 电子测试	PO=Purchase Order 订单
Tolerance 公差	Rigid,Flexible Board 刚性,软性板
Board cut 开料	Board baking 焗板
Drill 钻孔	PTH=Plated Through Hole 镀通孔,沉铜
Panel plating 板面电镀,全板电镀	Photo Image 图象,线路图形
Pattern plating 线路电镀	Etching 蚀板,蚀刻
SM=Solder Mask 防焊,阻焊,绿油	SR=Solder Resist 防焊,阻焊,绿油
Gold finger 金手指	Silkscreen 丝印字符
HAL=HASL=Hot air(Solder)leveling 热风整平喷锡	Routing 锣板,铣板
Punching 冲板,啤板	FQC=final quality checking 终检,最后检查
FQA=final quality audit 最后稽查(抽查)	Shippment 出货
Flux 松香	Au 金,Cu 铜,Ni 镍,Pb 铅,Tn 锡,Tin-lead 锡铅合金
Lead free 无铅	COC=compliance of certificate 材料证明书
Microsection=cross section 微切片,横切片	Chemical gold 沉镍金
Mould=punch die 模具,啤模	MI=manufacture instruction 制作批示
QA=quality assurance 品质保证	Drill bit size 钻咀直径<diameter>
Bow and twist 板弯和板曲	Hit 击打,孔数
Bonding 邦定,点焊	Thieving copper 抢电流铜皮
Break-up tab 工艺边	Break away tab 工艺边
GND=ground 地线,大铜皮	Hole edge 孔边,孔内
Stamp hole 邮票孔	Template 天坯,型板,钻孔样板(首板)
Dry film 干菲林,干膜	LPI=liquid photo image 液态感光=湿绿油
Multilayer 多层板	SMD=surface mouted device 贴片,表面贴装器件
SMT=surface mouted technology 表面贴装技术	Peelable mask=blue gel 蓝胶
Tooling hole 工艺孔,管位,定位孔,工具孔	Fiducial mask 测光点,光学对位点,对光点
Copper foil 铜箔	Dimension 尺寸
Negative 负的,positive 正的	Flash gold 镀金,镀薄金
Engineering department 工程部	Delivery date 交货期
Bevelling 斜边	Spacing=gap 间隙,气隙,线隙

## PCB 常用英文词汇汇编

### A

A.O.I(Automatic Optical Inspection) 自动光学检查	Acceptable quality level (AQL) 可接受质量水平
Accuracy 精确度	Activating 活化
Active carbon treatment 活性碳处理	After Pressed Thickness 压板后之厚度

Alignment	校直, 结盟	Annular ring	锡圈
Anti-Static Bag	静电胶袋	Apparatus	设备, 仪器
Area	面积	Artwork	菲林
Artwork Drawing	菲林图形	Artwork Film	原装菲林
Artwork Modification	菲林修改	Artwork No.	菲林编号
Assembly	组装, 装配	Axis	轴

**B**

Backplane	背板	Back-up	垫板
Baking	烘板	Ball Grid Array (BGA)	球栅阵列
Bare board	裸板	Base Copper	底铜(也叫基铜)
Base material	基材	Bevelling	斜边
Black Oxide	黑氧化	Blind via hole	盲孔
Blistering	起泡/水泡	Board Cutting	开料
Board Thickness	板厚	Bottom side	底层
Breakaway tab	打断点	Brushing	磨刷
Build-up	积层	Bullet pad	子弹盘
Buried hole	埋孔		

**C**

C/M(Component Marking)	元件字符	Carbon ink	碳油
Carrier	带板	Ceramic substrate	陶瓷
Certificate of Compliance	合格证书	Chamfer	倒角
Chemical cleaning	化学清洗	Chemical corrosion	化学腐蚀
Chip Scale Package (CSP)	晶片比例包装	Circuit	线路
Clearance	间距/间隙	Color	颜色

Component Side(C/S)	元件面	Composite layers	复合层
Computer Numerial Control (CNC)	数控	Conductor	导体
Conductor width/space	导体线宽/线隙	Contact	接点
Copper area	铜面积	Copper clad	铜箔
Copper foil	铜箔	Copper plating	电镀铜
Corner	角线	Corner mark	板角记号
Corner REG.Hole	角位对位孔	Cracking	裂缝
Creasing	皱折	Criteria	规格,标准
Crossection area	切面	Cu/Sn Plating	镀铜锡
Current efficiency	电流效率	Customer	客户
Customer Drilling File	客户钻孔资料	Customer P/N	客户产品编号

**D**

D/F Registration Hole	干菲林对位孔	D/F(Dry Film)	干膜
Date Code	日期代号	Datum hole	基准参考孔
Daughter board	子板	Deburring	去毛刺
Defect	缺陷	Definition	定义
Delamination	分层	Delay	耽搁
Delivery	交货	Densitomefer	透光度计
Density	密度	Department	部门
Description	说明	Design origin	设计原点
Desmear	去钻污,除胶	Dessicant	防潮珠
Developer	显影液,显影机	Diamond	钻石
Diazo film	重氮片	Dielectric breakdown	介电击穿



Dielectric constant	介电常数	Dielectric Thickness	介电层厚度
Dielectric Voltage Test	绝缘测试	Dimension	尺寸
Dimensional stability	尺寸稳定性	Direct/indirect	直接/间接
Distribution	发放	Document type	文件种类
Documentation Control	文件控制	Double sided board	双面板
Drill bit	钻咀	Drilling	钻孔
Drilling Roughness	钻孔粗糙度	Dry Film	干菲林
Dry Film-Pattern	干膜线路	Dynamic	动态
<b>E</b>			
ECN(Engineering Change Notification)	工程更改通知	Effective date	有效期
Electrical Test Fixture	电测试 针床	Electro migration	漏电
Electroconductive paste	导电胶	Electroless	无电沉
Electroless copper	无电沉铜	Electroless Ni	无电沉镍
Electroless Gold/Au	无电沉金	Engineering drawing	工程图纸
Entek	有机涂覆	Epoxy glass substrate	环氧玻璃基板
Epoxy resin	环氧基树脂	Etch	蚀刻
Etchback	凹蚀	Etching	蚀刻
E-Test Marking	电测试标记	E-Test(Electrical Test)	电测试
Exposure	曝光	External layer	外层

**F**

Fiducial mark	基准点	Filling	填充
Film Fabrication	菲林制作	Final QC	最终检查
Finish Overall Board Thickness	成品总板厚度	Fixture	夹具
Flammability	可燃性	Flash Gold	薄金

---

Flexible	易曲的,能变形的	Flux	助焊剂
----------	----------	------	-----

---

**G**

General information	一般资料	Ghost image	重影
Glass transition temperature	玻璃化湿度	Gold Finger(G/F)	金手指
Golden board	金板	Grid	网格
Ground plane	地线层		

---

**H**

HAL(Hot Air Leveling)	热风整平	Hand Rout	手锣
Hardness	硬度	Heat Sealed	热密封
Heat Shrink-warp	热收缩	Holding time	停留时间
Hole	孔	Hole breakout	破坏
Hole density	孔的密度	Hole Diameter	孔径
Hole location	孔位	Hole Location Chart	孔位座标表
Hole Position Tolerance	孔位误差	Hole size	孔尺寸
Hot Air Leveling(HAL)	热风整平	Humidity	湿度

---

**I**

Identification	标识,指标	Image	影像
Imaging transfer	图形转移	Impedance	阻抗
Impedance Test	阻抗测试	Inner copper foil	内层铜箔
Inspection	检验	Insulation resistance Test	绝缘测试
Inter Plane Separation	内层分离	Interleave Paper	隔纸
Internal layer	内层	Internal stress	内应力
Ionic cleanliness	离子清洁度	Isolation	孤立
Isolation Resistance	绝缘电阻	Item	项目

**K**

KEY board	键盘	Key slot	槽孔
Kraft paper	牛皮纸	KEEPOUT LAYER (禁止布线层)	

**L**

Laminate	板材	Laminate Thickness	材料厚度
Lamination void	层间空洞	Landless hole	破孔
Laser plotter	激光绘图机	Laser plotting	激光绘图
Laser via hole	激光穿孔	Layup	层压配本
Lay-up Instruction	压板指示	Legend	字符
Legend Width	字符宽度	Length	长度
Lifted Lands	残铜	Line Width	线宽
Liquid	液体	Location	位置
Logic diagram	逻辑图形	Lot size	批量 (这里指批量流程卡)

**M**

Mark	标记	Master drawing	菲林图形
Material Thickness	材料厚度	Material Type	材料类型
Max. X-out	坏板上限	Max.Board Thickness After Plating	电镀后最大厚度
Measling	白斑	Mech Drawing No.	图纸编号
Mechanical cleaning	机械清洗	Metal	金属
Method	方法	MI(Manufacturing Instruction)	生产制作指示
Microstrip	微条线	Min Conductor Copper Thickness	最小线路铜厚
Min Hole Wall Copper Thickness	最小孔壁铜厚	Min. Gold Plating Thickness	最小金厚
Min. Nickel Thickness	最小镍厚	Min. Tin-Lead Thickness (After HAL)	最小锡厚
Min. Annular Ring 最小环宽		Min.Spacing between Line to Line	线与线之间的最小距离

Min.Spacing between Line to Pad	线与焊盘之间的最小距离		
Min.Spacing between Pad to Pad	焊盘与焊盘之间的最小距离		
Minimum	最小	Mirroring	镜像
Missing	缺少	Model No.	产品名称
Molded	模塑	Mother board	主板
Moulding	模房	Mounting hole	安装孔
Multilayer	多层板	Multi-layer Laminate	多层板材料

**N**

Negative	反面的	Net list	网络表
Network	网络	Nick	缺口
No. of holes	孔数	No.of Array/Panel	每个拼板套板数
No.of Panel per Stack	每叠板数	No.of Panel/Sheet	每张大料拼板数
No.of Pcs Per Bag	每包数量	No.of Unit/Array	每套单元数
Normal value	标准值		

**O**

Oblong	椭圆形的	Offset	偏移
Open/short	开路/短路	Optimization(design)	最佳化(设计)
Organic Solerability Peservatives(OSP)	有机保护剂	Originator	原作者
Outer copper foil	外层铜箔	Outline	外形

**P**

Packing	包装	Packing	包装
Pad	焊盘	Panel Area	拼板面积
Panel Plated Crack	板镀缺口	Panel plating	整板电镀
Panel Size	拼板尺寸	Panel Size After Outerlayer Cutting	外层切板后拼板尺寸

Panel Utilization	拼板利用率	Pass rate	通过率
Passivation	钝化	Pattern	线路
Pattern Inspection	线路检查	Pattern plating	图形电镀
PCB(Printed Circuit Board)	印制线路板	Peck drilling	啄钻
Peel strength	剥离强度	Peelable	可剥性
Peelable	剥离强度	Peelable Mask	可脱油
Peeling	剥离	Permanent	永久性
PH value	PH 值	Photo plotting	图形输出
Photo via hole	菲林过孔	Photographers	照片靶标
Photoplotter	光绘机	Physical	物理的
Pin hole	销定孔	Pink ring	粉红环
Pinning hole	钻孔管位	Pitch	间距
Placement	放置	Plated Though Hole(PTH)	沉铜
Plating	电镀	Plating Crack	电镀裂缝
Plating line	电镀线	Plating rack	电镀架
Plating Void	电镀针孔	Plug Hole	塞孔
Polymer	聚合物	Porosity	孔隙率
Positive	绝对的	Power plane	电源层
Prepreg	半固化片	Primary side	首面
Print	印刷	Probe point	针床测点
Process	工序	Process flow	工序流程
Product Planning Dept.	生产计划部	Production	生产板
Profile	外形	Profiling	外形加工

Profiling Process	外形加工 n	Project No.	产品编号
PTH Thermal Seress Test	PTH 热冲击测试	PTH(Plating Through Hole)	沉铜
Pull away	拉离	Punch	啤模
Punching	冲切	Punching Mould Drawing	啤模图形

**Q**

QA Audit	品质审计	QA(Quanlity Assurance)	品质部
Quad Palt Pack (QFP)	四边扁平林整器件	Quality	质量
Quantity	数量		

**R**

Raw Material Utilization	原材料利用率	Recall	回收
Rectifier	整流器	Register mark	对位点
Registration	重合点	Remark	备注
Resin	树脂	Resin Recession	流胶
Resist	抗蚀剂	Resolution	分辨率
Rigid	精密的	Roller coating	涂覆
Roughening	粗化	Round pad	圆盘
Routing	外形加工,铣板		

**S**

S/M Material	绿油物料	S/M(Solder Mask)	阻焊
Sales	销售	Sample	样板
Sampling inspection	抽样检验	Scaling factor	缩放比例因素
Scope	范围	Scoring	刻槽
Scratch	划痕	Secondary side	第二面
Section Code	组别代号	Section Code Change	组别代号更改

Segment	部分,片段	Separated	分离
Sequence	顺序	Sets	套
Sheet Size	大料尺寸	Schematic diagram	原理图
Shiny	发光的	Silk screen	丝印
Silver film	银盐片(黑菲林)	Single/double	单层/双面
Slot	槽,坑	Smear	污点
Solder Mask	阻焊	Solder mask on bare copper (smobc)	裸铜覆盖阻焊膜
Solder side	焊接面	Solder Side C/M	阻焊面字符
Solder Side Cir.	焊接面线路	Solder Side Circuit	焊接面
Solder Side S/M	焊接面阻焊	Solderability	可焊性
Solvent Test	可溶性测试	Spacing	线距
Special requirement	特殊要求	Specification	详细说明,规范
Spindle	主轴	Split	裂片
Square pad	方块	Standard	标准值
Static	静态	Stencial	网版
Step drilling	分布钻	Step scale	光梯尺(曝光尺)
Store	货仓	Supplier	供应商
Supported hole	支撑点	Surface	表面
Surface mount technology	表面组装技术	Swimming	滑移

T

Tack	堆起	Tape Programming	铬带制作
Tape Test	胶带测试	Target Hole	目标孔
Teardrop	泪珠	Template	天平

Tenting	封孔	Test	测试
Test coupon	图样	Test Parameter	测试参数
Test Pattern	测试孔	Testing Voltage	电压
Thermal shock	热冲击	Thermal stress	热应力
Thickness	厚度	Tin Content	锡含量
Tin/Lead Stripping	退铅锡	Tin-lead plating	电镀铅锡
Tolerance	公差	Top side	板面
Touch up	修理(执漏)	Training	训练
Transmission	传输线	Transmittance	传送
Trim line	修剪		
<b>U</b>			
Ultrasonic cleaning	超声波清洗	Undercut	侧蚀
Unit Arrangement	单元排版	Unit Layout Per Panel	单元拼板图
Uv-blocking	阻挡紫外线		
<b>V</b>			
Vacuum Pack	真空包装	Vacuum lamination	真空压制
V-Cut	V- 坑	View From...	观察方向由...
Visual & Warpage	可视性和翘曲度	Visual inspection	目检
Voltage	电压		
<b>W</b>			
W/F(Wet Film)	湿膜	Warp & Twist	翘曲和弯曲
Width	宽度	Wiring	线路



## Genesis2000 常用英文注解

Create 创建	Rename 更改	Delete 删除	Export job 输出料号
Import job 导入料号	Save 保存	Quit 离开	Input 导入
Output 导出	Matrix 模板	Steps 工作单元	Symbols 元素库
Wheels /D 码库	Path 路径	Job 料号	Step 工作单元
Editor 编辑	Exclude 排除	Identify 识别	Translate 转换
Close 退出	Insert 插入	Add 增加	Row 行
Column 列	Orig 原始	Edit 编辑	Board 板
Misc 混合层	Signal 信号	Power_ground 电源	Mixed 混合层
Solder_mask 阻焊	Silk_screen 丝印	Solder_paste 锡膏	Drill 钻孔
Rout 锣带	Document 文档	Positive 正性	Negative 负性
File 文件	Save 保存	Script 脚本	Locks 锁
Close 退出	EDIT 编辑	Undo 撤消	Delete 删除
Move 移动	Copy 拷贝	Same Layer 同层	Other Layer 另一层
Step&Repeat 陈列	Apply 应用	Close 关闭	Substitute 替换
Resize 放大/缩小	Global 改变大小	Transform 改变	Connections 倒角
Reshape 更改集合	Change symbol 更改元素	Break 打散	Arc to Lines 弧转线
Line to Pad 线转PAD	Pad to line 盘转线	Contourize 铜皮转光栅	Fill 填充
Polarity 极性	Positive 正	Negative 负	Invert 转换
Create 创建	Symbol 元素符号	Profile 轮廓	Layer 层
Padup 谷大pad	paddn 缩小pad	reroute 绕线路	Shave 削pad
linedown 缩线	line/signal 线	in 里面	out 外面
Same layer 同一层	Other layer 另一层	cu 铜皮	spacing 间隙
top 顶层	bot 底层	Soldermask 绿油层	silk 字符层
Close 关闭	zoom 放大缩小	create 创建	snap 捕捉
board 板	Route 锣带	repair 修理、编辑	resize 放大缩小
analysis 分析	Sinde 边、面	Advanced 高级	measuer 测量
output 导出	PTH hole 沉铜孔	NPTH hole 非沉铜孔	VIA hole 导通孔
smd pad 贴片	replace 替换	Attribute 属性	Select 选择
round 圆	square 正方形	rectangle 矩形	Reshape 改变形状
profile 轮廓	drill 钻带	rout 锣带	Actions 操作流程
DFM 自动功能	circuit 线性	Identify 识别	Translate 转换
job matrix 工作室	repair 修补、改正	Misc 辅助层	dutum point 相对原点
corner 直角	optimization 优化	origin 零点	center 中心
global 全部	check 检查	reference layer 参考层	reference selection 参考选择
reverse selection 反选	snap 对齐	invert 正负调换	symbol 元素
feature 半径	histogram 元素	exist 存在	angle 角度
dimensions 标准尺寸	panelization 拼图	fill parameters 填充参数	redundancy 冗余、清除
Select Drawn 选铜	Graphic Snapshot 切图	Netlist Analyzer 网络对比	Notes 标注